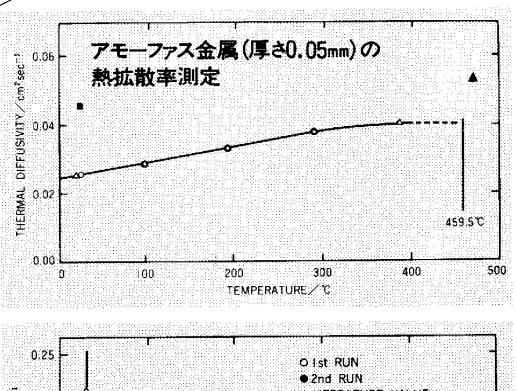
1-5

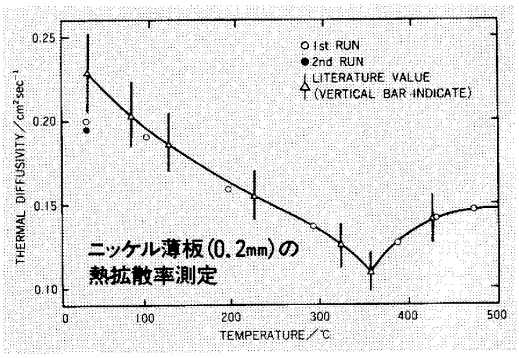
薄板,フィルム状試料,コーティング層の
伝熱特性の評価に。

光交流法熱定数測定装置
PIT-1
新製品

現在、半導体素子のICメモリをはじめとして、薄膜、厚膜、薄板状試料はますます多用される傾向にあります。これらの材料の熱的特性を知ることは製品開発に極めて重要ですが、既存の測定技術では決して容易なことではありませんでした。PIT-1はACカロリメトリの原理を応用し、世界に先駆けて厚さ0.005mmの極薄材料に挑戦。材料の面方向の熱拡張率、比熱、熱伝導率測定を可能にしました。従来測定困難であったアモーファス金属、半導体材料、セラミック薄板、基板上のダイヤモンド膜、高分子フィルムなどの伝熱特性の評価に不可欠なデータを提供することができます。

●試料サイズ: 熱拡散率用10×4mm、厚0.3mm以下　比熱用4×4mm、厚0.1～0.3mm　●熱拡散率測定範囲: 0.005～2.0cm²/s
●測定温度: 室温～500℃　●測定精度: ±5 %(再現性)





真空理工株式会社

AE事業部
本社営業部〒226横浜市緑区白山町300☎(045)931-2285～7
大阪営業所〒530大阪市北区梅田1-11-4-2100大阪駅前第4ビル
☎(06)344-0325

昭和二十三年十月十一日　昭和六十年十一月二十五日　印刷納本
昭和六十年十二月一日　発行　(毎月一回一日発行)　第三種郵便物認可
編集兼発行人　東京都千代田区大手町一-九-四経団連会館内　木下亨
印刷人　東京都板橋区熊野町十三-十一　倉沢直則
〒一〇〇(電話東京〇三(二七九)六〇二一)　経団連会館三階　社団法人日本鉄鋼協会
郵便振替口座東京七-一九三番　(会員の購読料は会費に含む)